

**华润微电子有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

（2023 年 07 月）

证券简称：华润微

证券代码：688396

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称        | <b>07 月 17 日 10:00-11:00, 13:30-14:30</b><br>富瑞证券、SEMI、中邮证券、淳厚基金、大家资产、东吴基金、广发基金、国寿资产、嘉实、建信、垒富基金、浦银安盛、睿扬投资、上海汐泰投管、泰达宏利、泰康资产、天弘、新华资管、中金公司资管、中欧基金、中信保诚基金、中邮人寿、浦银国际、西南证券、汇添富基金、安融通基金、西南证券、中信保城、摩根士丹利                                                                                                   |
| 时间            | 07 月 17 日 10:00-11:00, 13:30-14:30                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 无锡                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 上市公司接待人员姓名    | 吴国屹    华润微电子董事、财务总监兼董秘<br>沈筛英    华润微电子投资者关系高级经理                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <b>问题一：请问目前下游终端应用市场景气度如何？三季度价格是否会起稳？</b><br><br>答：下游终端应用中，消费电子需求仍未起稳，汽车电子、光伏、储能等市场景气度较高。公司目前订单量有所增加，但三季度产品价格上仍有一定压力。                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>问题二：请问公司碳化硅的产品类别及 2023 年预期规划？</b></p> <p>答：公司在碳化硅二极管市场拓展基础上，进一步推进 SiC MOSFET 产品规模上量，碳化硅产品全年营收力争超过 6000 万元。</p> <p><b>问题三：请问公司碳化硅产品的应用领域有哪些？</b></p> <p>答：公司碳化硅产品目前主要应用在汽车电子、充电桩、光伏、储能四大领域。</p> <p><b>问题四：请问公司氮化镓产品的主要应用？</b></p> <p>答：公司氮化镓产品主要应用在手机快充、网通电源适配器、伺服电机电源、服务器电源、电网电表、助力车充电器、LED 电源等。</p> <p><b>问题五：请问公司目前衬底及外延的国产化情况？</b></p> <p>答：目前公司 6 吋、8 吋衬底片国产化率约为 50%；外延片国产化率已实现 80%。</p> <p><b>问题六：请问公司设备及材料的国产化情况？</b></p> <p>答：公司秉承 SQDC（安全、质量、交付、成本）四项原则，积极推进设备、材料国产化验证，推动并加快相关领域的国产化进程。</p> <p><b>问题七：请问公司目前晶圆制造产能利用率？</b></p> <p>答：今年年初到目前为止，公司 6 吋、8 吋产能保持满载状态；重庆 12 吋处于产能爬坡及新产品客户验证阶段。</p> <p><b>问题八：请问公司目前封装的产能情况及产能利用率？</b></p> <p>答：公司目前封装月产能逾 8.7 亿颗，封装的产能利用率较去年有所提升。</p> <p><b>问题九：请问公司 IGBT 产品的预期规划？</b></p> <p>答：公司 IGBT 产品已从 6 吋产线升级到 8 吋产线，未来逐步升级到 12 吋产线，并扩充相应产能。2023 年公司 IGBT 产品较去年仍会保持高速增长。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>问题十：请问 IGBT 市场供需情况及应用领域？</b></p> <p>答：IGBT 单管市场供需基本匹配，IGBT 模块产品相对紧缺。公司 IGBT 产品 85%应用在汽车电子和工控领域。</p> <p><b>问题十一：请问第三代半导体目前发展及后期规划？</b></p> <p>答：公司碳化硅和氮化镓均已实现量产，SiC MOS 第一代平面型 MOS 器件性能国内领先，同时已启动开发第二代沟槽型 MOS 产品。2023 年第三代半导体营收将较去年实现翻番。</p> <p><b>问题十二：请问公司封测基地项目进展如何？此前有看到消息，国家大基金二期拟收购华润润安的股权，进展如何？</b></p> <p>答：公司封测基地项目已于 2022 年底如期通线，目前正推进规模量产建设。公司成功引入国家集成电路产业投资基金二期对润安增资，共同建设功率半导体封测基地，6 月底已完成工商变更。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 日期       | 2023 年 07 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |